

- 일시 / 장소: 2023년 4월 5일(수)-6일(목) / 수원컨벤션센터 4층 세미나실
- 주관: (사)한국마이크로전자 및 패키징 학회
- 문의: T. 02-538-0962 E. kmeps@kmeps.or.kr

2023년 4월 5일(수)

	Solder & Interconnection (좌장: 윤정원, 충북대학교)	Emerging Technologies (좌장: 이종현, 서울과학기술대학교)
	Room 405/408 (4F)	Room 401/402 (4F)
10:00 - 10:25	(초청) 친환경 반도체 패키징을 위한 저온 솔더 양산 확대 적용 필요성과 그 한계 / 주건모(삼성종합기술원)	(초청) Thermal Packaging Utilizing Gallium-Based Liquid Metals / 남영석(카이스트)
10:25 - 10:50	(초청) ENEPIG 타입과 솔더 조성에 따른 금속간 화합물과 파괴모드 연구 / 이선희(대덕전자㈜)	SMART Metallization for Reliable Neuromorphic Edges / 연한울(광주과학기술원)
10:50 - 11:15	(초청) 구리 나노 조도 형성 방법을 활용한 마이크로 패키지 기판의 미세화로 제조공정 / 정보목(와이엠티㈜)	차세대 반도체 후공정 장비를 위한 사용자 친화적인 머신 비전 소프트웨어 개발 / 한기준(한성대학교)
11:15 - 11:35	Coffee Break	
	Room 405/408 (4F)	
11:35 - 11:40	개회사(강사운 학회장) (좌장: 손윤철, 조선대학교)	
	Plenary Talk (좌장: 손윤철, 조선대학교)	
	Room 405/408 (4F)	
11:40 - 12:10	Advanced Packaing Technology for High Performance Computing / 박성순(㈜인텔코리아)	
12:10 - 12:40	HPC/AI용 반도체 패키징 기술 / 김재동(엠코테크놀로지코리아㈜)	
12:40 - 13:40	Lunch 4층 Lobby	
13:40 - 15:00	포스터 발표 (좌장: 유세훈, 한국생산기술연구원)	
	Keynote Talk (좌장: 고용호, 한국생산기술연구원)	
	Room 405/408 (4F)	
15:00 - 15:30	접합기술동향: 더 많은 I/O를 위해 더 미세화 되는 접합 간격 / 서민석(SK하이닉스㈜)	
15:30 - 16:00	차세대 패키지 시장 전망과 기술 동향 / 조병연(삼성전자㈜)	
16:00 - 16:20	Coffee Break	
	특별세션 I (이종집적 및 칩렛 패키징 기술) (좌장: 박영배, 안동대학교)	Test & Reliability (좌장: 연한울, 광주과학기술원)
	Room 405/408 (4F)	Room 401/402
16:20 - 16:45	ABS1: 칩렛 NPU-HBM 통합 칩단패키징 페타스케일 AI반도체 / 권영수(한국전자통신연구원)	(초청) Electrical Design & Analysis for Chiplet Package / 한기진(동국대학교)
16:45 - 17:10	Recent Advances and Trends in Heterogeneous Integration / 김사라은경(서울과학기술대학교)	TKD와 ASTAR를 이용한 유연소자용 금속 박막의 기계적 변형에 따른 미세구조 분석 / 이소연(금오공과대학교)
17:10 - 17:35	Thermoreflectance-Based Thermometry for Electronics Packaging / 장혜진(서울대학교)	Wafer Topography Measurement Technology for Wafer Level Package Process / 박품성(SK하이닉스)
17:35 - 18:00	칩렛 집적을 구현하는 타일링 접합 기술 / 최광성(한국전자통신연구원)	초음파 충격에 의한 기판 위의 회로 밀착력 검증에 대한 연구 / 박병엽(대덕전자)
	코트야드 메리어트 수원 - 레이크 파크 볼룸	
18:20 - 20:00	만찬 (일반 행운권 추첨)	

2023년 4월 6일(목)

	Characterization & Simulation(좌장: 최광성, 한국전자통신연구원)	특별세션 II (2022년 학회상 수상자)(좌장: 김병준, 한국공학대학교)
	Room 405/408 (4F)	Room 401/402 (4F)
10:00 - 10:25	(초청) 초고속 PKG의 전기적 설계 및 해석 / 김중훈(㈜이엠씨닥터스)	다층-다물리 역학기반 패키징 신뢰성 예측 / 김학성(한양대학교)
10:25 - 10:50	(초청) New Technologies in Package Level EMI Shielding and Thermal Dissipation Materials and Process / 정세영(엔트리움㈜)	미세피치 Thermocompression (TCB) 인터커넥션 기술 / 유세훈(한국생산기술연구원)
10:50 - 11:15	다물리(전자기-화학-열-기계 연계)역학이론 및 시스템설계로의 응용 / 이은호(성균관대학교)	Cu/oxide 하이브리드 본딩 기술 / 김성동(서울과학기술대학교)
11:15 - 11:40	무선 웨어러블 기기를 위한 신축성 RF 전자소자 및 패키징 기술 / 정예환(한양대학교)	플렉시블 어플리케이션을 위한 고분자 필름 접합 기술 개발 / 이태익(한국생산기술연구원)
11:40 - 13:00	Lunch	
	High Density Integration(좌장: 김성동, 서울과학기술대학교)	Materials & Processing(좌장: 이광주, LG화학)
	Room 405/408 (4F)	Room 401/402 (4F)
13:00 - 13:25	(초청) 시스템 반도체와 패키징 / 임재명(한양대학교)	(초청) 수전해용 나노소재 촉매 / 한혁수(건국대학교)
13:25 - 13:50	(초청) 유한요소해석을 이용한 Hybrid Cu Bonding이 적용된 전자패키지의 열적 기계적 특성 분석 / 박아영(한국기계연구원)	(초청) Sn-Bi 저온 솔더 페이스트를 사용한 메모리 모듈 조립 공정 및 신뢰성 개선 연구 / 장동민(삼성전자㈜)
13:50 - 14:15	(초청) Comparison of Electroplated Copper Patterns in RDL Fabrication on Wafer and PCB Substrates / 소홍윤(한양대학교)	미세 피치 플립 칩 공정을 위한 Breath Figure 기반 이방성 솔더 필름 개발 / 최광문(한국전자통신연구원)
14:15 - 14:30	Coffee Break	
	Young Scientist Session - Test & Reliability (좌장: 김택수, 한국과학기술원)	Young Scientist Session - Novel Packaging Technology (좌장: 방정환, 한국생산기술연구원)
	Room 405/408 (4F)	Room 401/402 (4F)
14:30 - 14:50	팬아웃 패키지 적용을 위한 폴리이미드 도포층/Cu 재배선 구조의 계면신뢰성 평가 및 분석 / 김가희(안동대학교)	EMC 경화 공정 조건에 따른 반도체 패키지 거동 예측 / 엄희진(한양대학교)
14:50 - 15:10	누설 전류 감소를 위한 이산화 규소 벽을 포함한 실리콘 관통 비아 구조의 신호 무결성 분석 및 설계 / 김현웅(카이스트)	Temperature-Dependent Elastic Properties of Thin Molded Underfill / 김준모(카이스트)
15:10 - 15:30	모터 전류를 이용한 반도체 생산 장비의 벨트 구동 시스템 건전성 진단 / 구희재(성균관대학교)	Fanless, Porous Copper-graphene Composite for Heat Management of Micro Devices / 노호균(전남대학교)
15:30 - 15:50	디스플레이 IC 접합을 위한 무시안 Au 범프의 열처리 온도에 따른 전단강도 평가 및 분석 / 김혜진(안동대학교)	IPL 광소결을 활용한 Cu-CNT 고방열 열계면소재의 열전달 특성 연구 / 김태유(한국생산기술연구원)
15:50 - 16:10	Analysis of Deformation Path for Solder Joint of Semiconductor Under Various Loading Condition / 임재혁(성균관대학교)	딤러닝을 활용한 커패시터의 잔존수명 예측 / 한영구(한양대학교)
	Room 405/408 (4F)	
16:10 - 16:30	폐회식 (포스터 & Young Scientist 시상식, 학생 행운권 추첨)	